

Endurecedores Epóxicos Base Agua

Series Gaskamine

Formulación Recomendada para Recubrimientos
Hoja de Especificaciones



Información de Contacto

Japón

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.

Phone: +81-3-3283-4794

E-Mail: mxda@mgc.co.jp

Europa

Mitsubishi Gas Chemical Europe GmbH

Phone: +49-211-363080

E-Mail: contact@mgc-europe.de

Singapur

Mitsubishi Gas Chemical Singapore Pte. Ltd.

Phone: +65-6224-0059

E-Mail: contact@mgcs.com.sg

China

Shanghai Ryoyo Trading Co., Ltd.

Phone: +86-21-5228-0585

E-Mail: gejing@ryoyotrading.com

USA

Mitsubishi Gas Chemical America, Inc.

Phone: +1-212-687-9030

E-Mail: contact@mgc-a.com

Tailandia

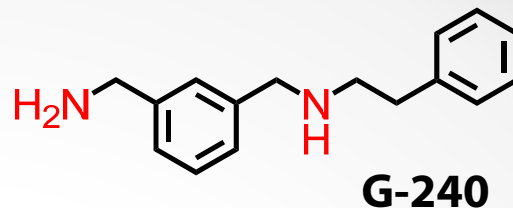
MGC Trading Thailand Ltd.

Phone: +66-2-670-3417,3418

E-Mail: contact@mgc.co.th

Gaskamine 240 ~ Endurecedor Base Agua Libre de COV ~

- **Baja Viscosidad**
- **Curado Rápido**
- **Buena Apariencia**
- **Libre de Compuestos Orgánicos Volátiles**

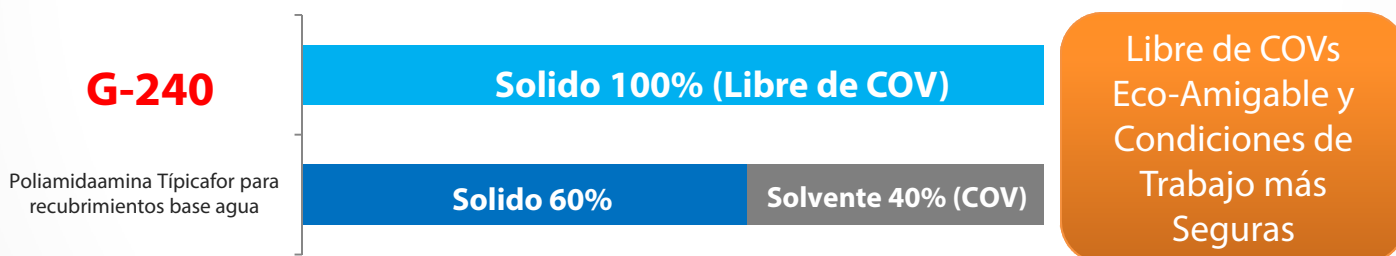


Color (Gardener)	Viscosidad (25°C)	AHEW	Solidos (NVM)	MXDA	Potlife(*) (23°C, 300g escala)
<1 (Amarillo Pálido)	66mPa·s (Ultra Baja Viscosidad)	103 (Bajo Phr)	100% (Sin Solvente)	<1wt% (No se Enrojece)	72min (Max Temp. ...32°C)

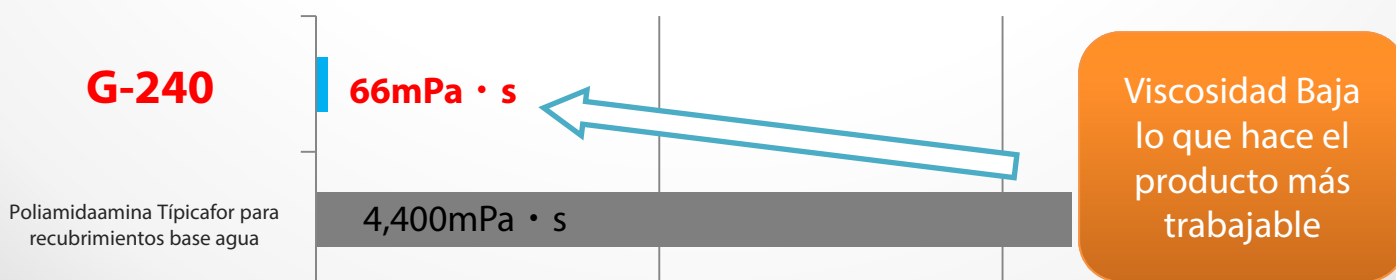
(*) Resina Epóxica...#1001 Bisfenol A Resina Epóxica Tipo Sólida Base Emulsion

G-240 Ventajas vs. Poliamidaamina Típica

<NVM>



<Viscosidad>

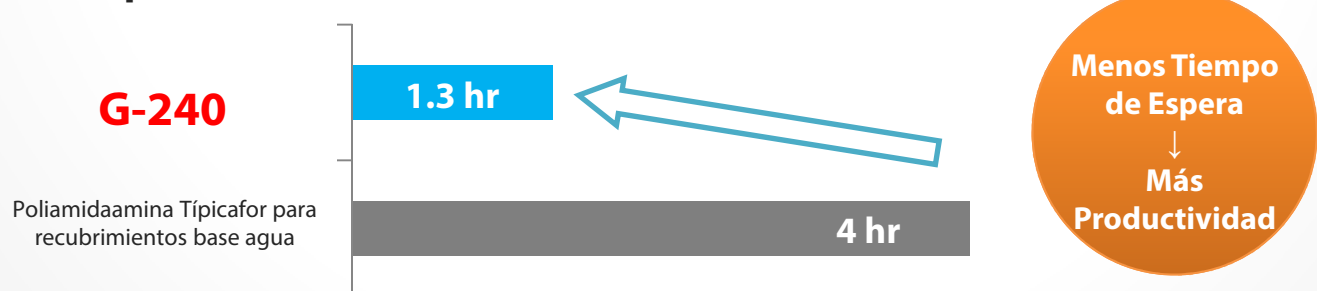


Formulación Recomendada

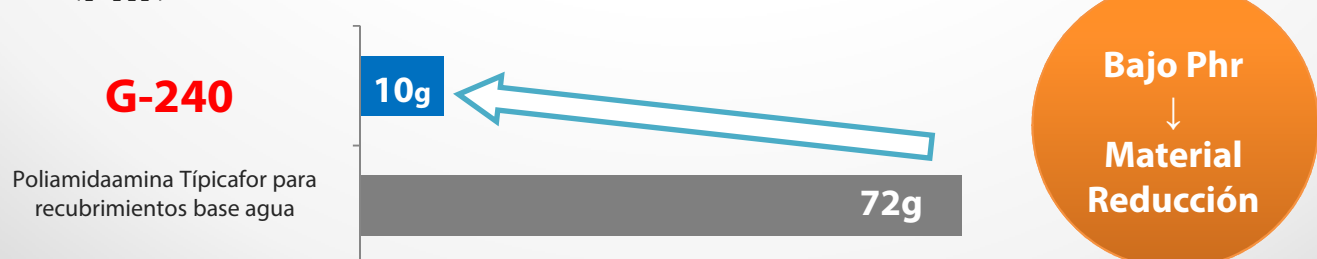
		Base Agua G-240 (Sin-COV)	Poliamidaamina Típica (COV)	G-240 (Sin-Solvente)	
Formulaciones	Resina Epóxica	#1001 Bisfenol A Resina Epóxica Tipo Sólido Base Emulsion NVM: 55% EEW: 1020 (tal como se suministra)		Bisfenol A Resina Epóxica Tipo Modificada (#828 + EDAD)	
		100g	100g	100g	
	Endurecedor	10g (Bajo Phr)	72g	52g	
Condiciones de Curado	Substrato	Acero Tratado con Fosfato de Zinc			
	Espesor de Película (Húmeda)	200µm (Espesor de Recubrimiento)			
	Condición de Curado	23°C, 50%RH (No se requiere Curado con calentamiento)			
Propiedades del Recubrimiento	RCI Secado Tiempo	Listo para Tocar	0.1hr	0.7hr	6.5hr
		Libre de Polvo	1.3hr	4.0hr	13.0hr
		Secado Hasta	6.4hr	>24hr	>24hr
	Sequedad (Después de 1 día)	Ex	Ex	Ex	
	Prueba de Resistencia al agua (Después de 1/2/7 días)	Ex/Ex/Ex	G/G/Ex	G/G/Ex	
	Dureza de Lápiz (Después de 1/2/7 días)	H/H/H	<6B/B/H	HB/F/H	
	Apariencia (Claridad / Nivelado / Brillo)	Ex/F/Ex	Ex/Ex/Ex	Ex/Ex/Ex	

Dureza de Lápiz: (Duro)2H>H>F>HB>B>2B>3B>>>6B(suave)
Ex: Excelente> G: Bueno> F: Aceptable> P: Malo> VP: Muy Mal

<Tiempo de Curado (Libre de Polvo)>



<Phr>



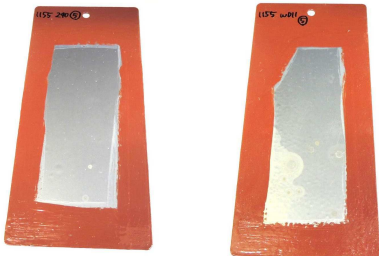
Curado Rápido, Buena Resistencia al agua y Buena Apariencia

Resistencia Química (Inmersión por 2 semanas)

	Base Agua G-240 (Sin-VOC)	Base Agua Poliamidaamina Típica (COV)	Sin-Solvente G-240 (Sin-COV)
Agua	Bueno (Ligeramente Reducción del Brillo)	Medio (Rugosidad en la Superficie)	Excelente
10wt% NaOH aq.	Bueno (Ligeramente Reducción del Brillo)	Malo (Oxidación)	Malo
10wt% H₂SO₄ aq.	Bueno (Ligeramente Reducción del Brillo)	Muy Mal (Oxidación, Hinchazón)	Malo
Metanol	Medio (Blanqueamiento)	Malo (Blistering)	Bueno
90wt% Metanol aq.	Medio (Blanqueamiento)	Malo (Blistering)	Medio
Tolueno	Medio (Blanqueamiento)	Muy Mal (Swelling)	Muy Mal
5wt% Spray de Sal (1 semana)	Medio (Blanqueamiento)	Malo (Oxidación)	Malo

<Apariencia después de la Inmersión>

10wt% NaOH aq.



G-240
Bueno

Poliamidaamina
Malo

10wt% H₂SO₄ aq.



G-240
Bueno

Poliamidaamina
Muy Mal

G-240 = Sin Oxidación,
Hinchazón o
Abración

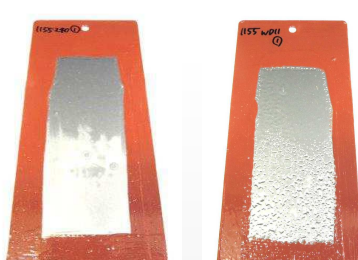
90wt% MeOH aq.



G-240
Medio

Poliamidaamina
Malo

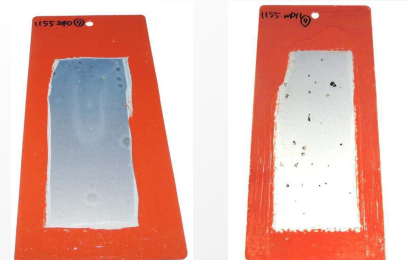
Tolueno



G-240
Medio

Poliamidaamina
Muy Mal

5wt% Spray de Sal

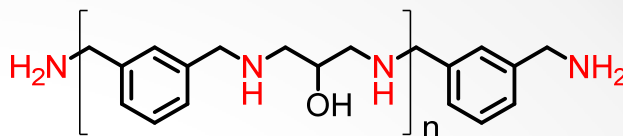


G-240
Bueno

Poliamidaamina
Malo

Gaskamine 328 ~ Sin-COV Poliamina Soluble en Agua ~

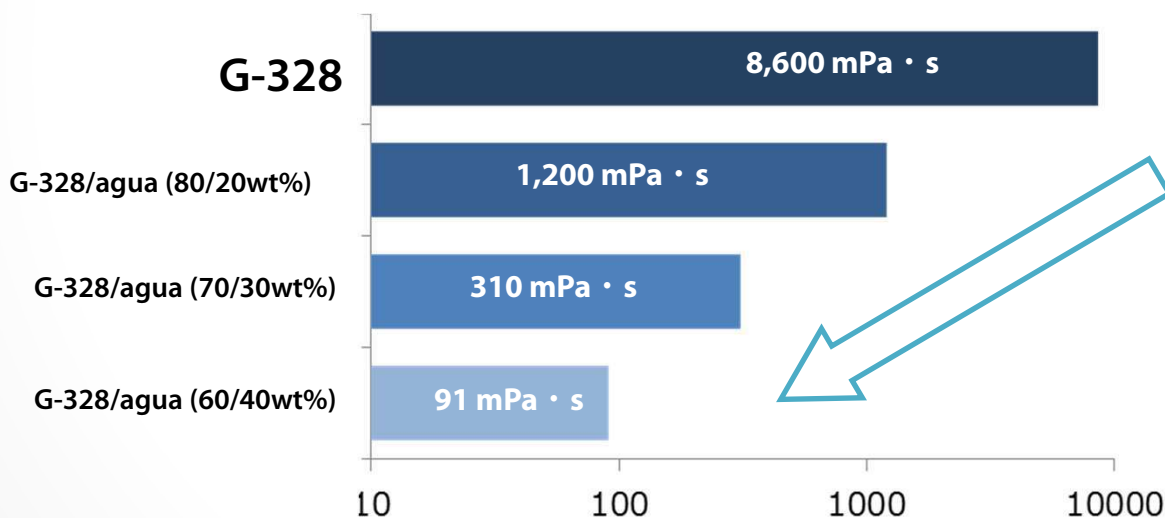
- **Sin-COV**
- **Soluble en agua**
- **Curado Rápido**
- **Poliamina de alta Tg**



G-328

Color (Gardener)	Viscosidad (25°C)	AHEW	Solidos (NVM)	MXDA
≤5 (Amarillo Pálido)	7,000 – 14,000 mPa·s	55 (Bajo Phr)	100% (Sin Solvent)	24 – 28 wt%

<Viscosidad>



Viscosidad Reducida con Agua

Formulación Recomendada para Primer Concreto

			G-328 / Agua (80wt%/20wt%) (Sin-COV)	Poliamida amina Típica (COV)
Formulaciones	Base Agua Resina Epoxica	1001 Bisfenol A Solido Tipo de Base Resina Epoxica NVM: 55% EEW: 1020 (como es suministrada)	100g	100g
	Endurecedor		G-328: 5.4g Aqua: 1.35g (Baja Viscosidad, Bajo Phr)	72g
Condiciones de Curado	Substrato		Tablero de Pizarra (Mortero de Cemento Reforzado)	
	Espesor de la Película (Humeda)		100µm	
	Condición de Curado		23°C, 50%RH	

Propiedades de Recubrimiento (23°C, 50%RH)

		G-328 / Aqua (80wt%/20wt%) (Sin-COV)	Poliamida amina Típica (COV)
RCI Tiempo de Secado	Listo para tocar	0.1hr	0.7hr
	Libre de Polvo	0.9hr	4.0hr
	Secado hasta	2.1hr	>24hr
Secado (después de 1 día)		Ex	Ex
Dureza de Lápiz (después de 1/2/7 días)		H/H/H	B/H/H

Ex: Excelente> G: Bueno> F: Medio> P: Malo
Dureza de Lápiz: (duro) 2H>H>F>HB>B>2B>3B>>>6B (suave)

Curado Rápido, Buena dureza de lápiz